



Electronics for the Future

決算発表 補足資料

2024年度 第2四半期業績

2024年11月8日
ローム株式会社
広報IR部

2024年度 第2四半期 実績 業績報告 (前年同期比)



(単位：億円)

	FY2024 第2四半期 実績	FY2023 第2四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,137	1,191	▲54	▲4.5%
営業利益	▲22	121	▲143	-
(対売上比率)	(▲2.0%)	(10.2%)	-	-
経常利益	▲93	220	▲314	-
(対売上比率)	(▲8.2%)	(18.5%)	-	-
純利益	▲13	171	▲185	-
(対売上比率)	(▲1.2%)	(14.4%)	-	-
EBITDA	183	286	▲103	▲36.1%
(対売上比率)	(16.1%)	(24.0%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (150.26円) (145.44円)

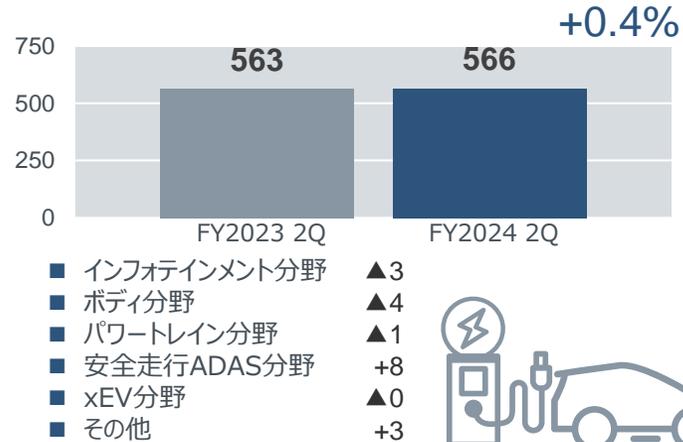
期末レート(¥/US\$) (142.73円) (149.58円)

(単位：億円)

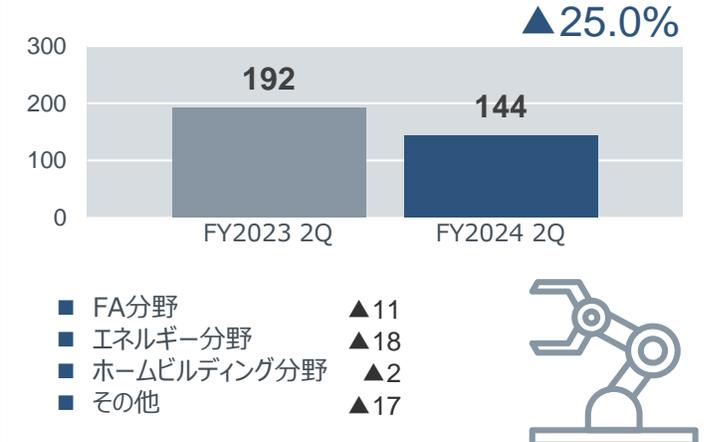
四半期売上高



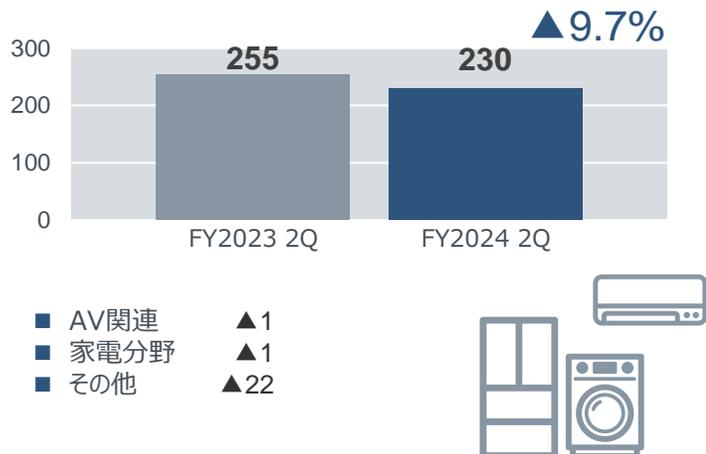
自動車



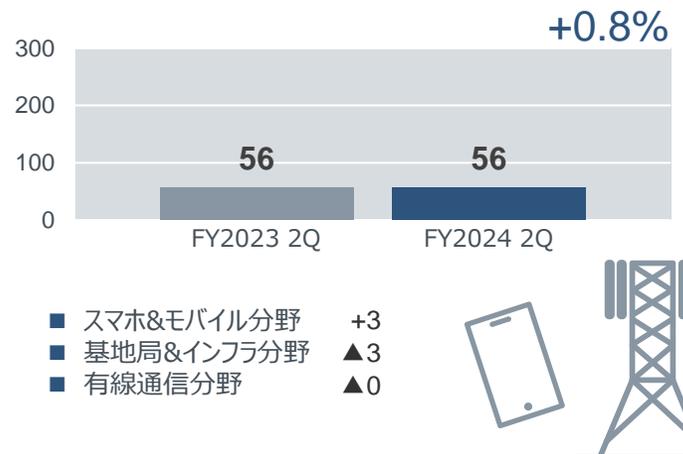
産機



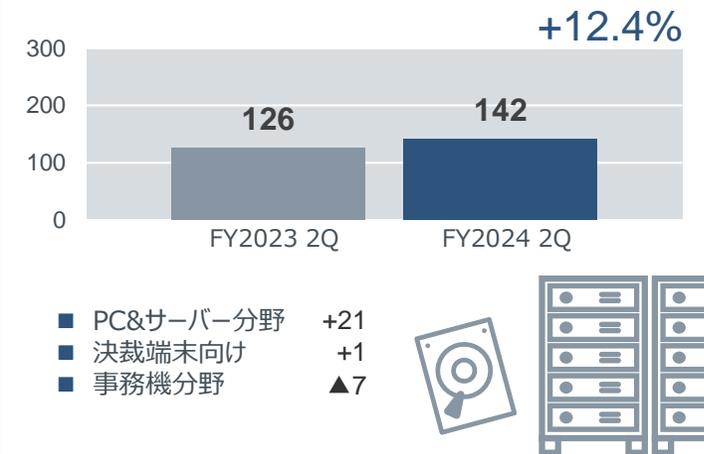
民生



通信



コンピュータ & ストレージ



2024年度 第2四半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)

四半期売上高

1,191億円

1,137億円

FY2023 第2四半期実績

FY2024 第2四半期実績

▲4.5%

海外売上高比率

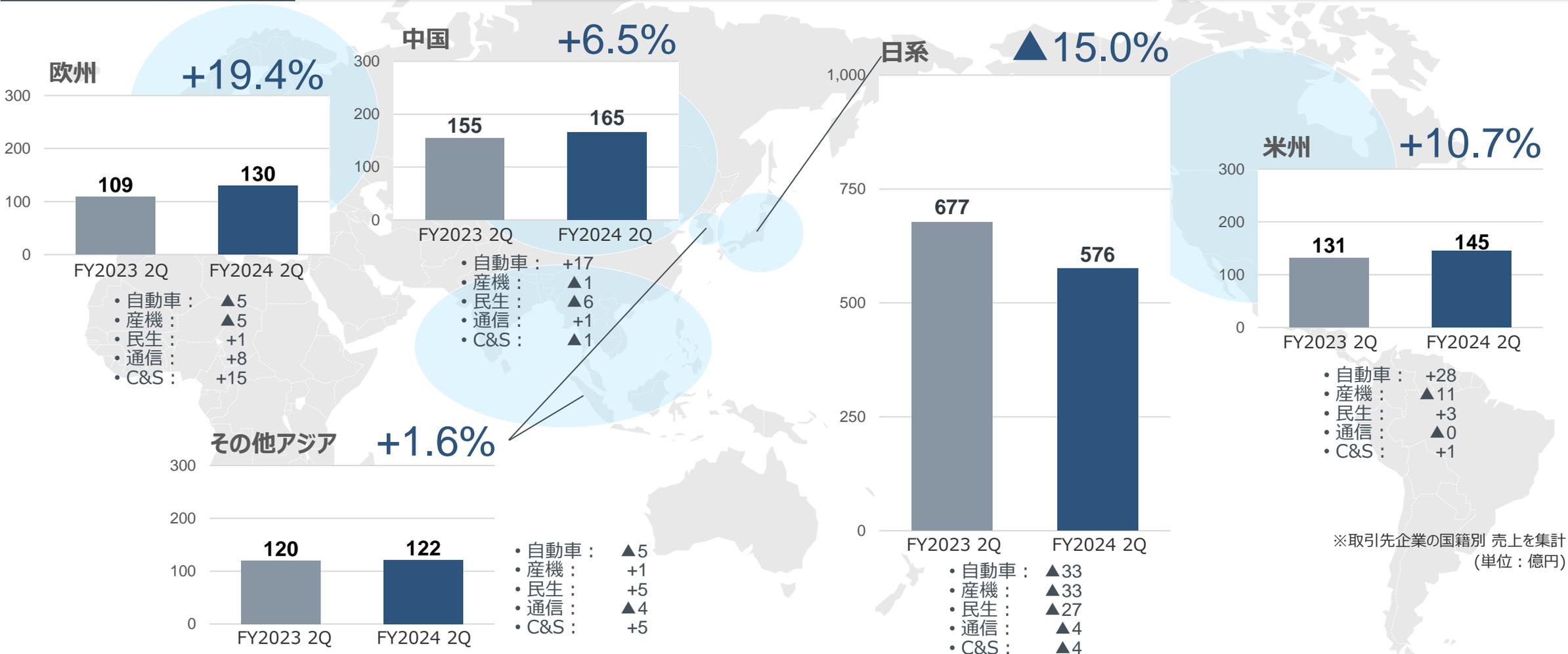
43.2%

FY2023 第2四半期

49.4%

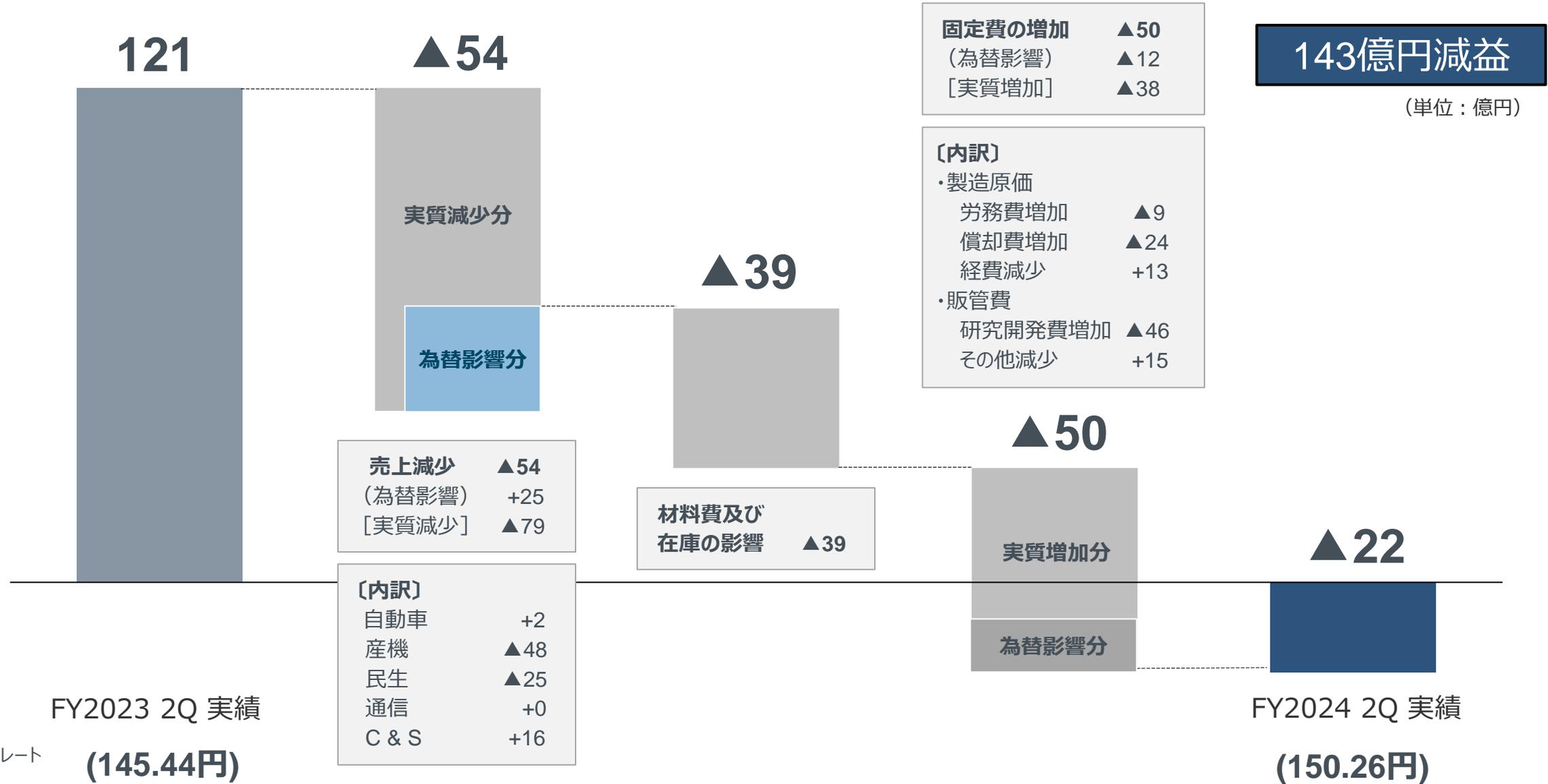
FY2024 第2四半期

第2四半期 前年同期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

2024年度 第2四半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)



期中平均レート (¥/US\$)

2024年度 第2四半期 セグメント別 (前年同期比)

(単位：億円)

		FY2024 第2四半期 実績	FY2023 第2四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	504	532	▲27	▲5.1%
	セグメント利益	15	44	▲29	▲65.7%
	(利益率)	(3.0%)	(8.4%)	-	-
半導体素子	売上	483	504	▲21	▲4.3%
	セグメント利益	▲54	52	▲107	-
	(利益率)	(▲11.3%)	(10.4%)	-	-
モジュール	売上	87	88	▲0	▲0.5%
	セグメント利益	13	14	▲1	▲7.7%
	(利益率)	(15.5%)	(16.7%)	-	-
その他	売上	61	66	▲4	▲4.5%
	セグメント利益	8	6	+1	+20.3%
	(利益率)	(13.4%)	(10.4%)	-	-

2024年度 第2四半期 実績 業績報告 (直前四半期比)

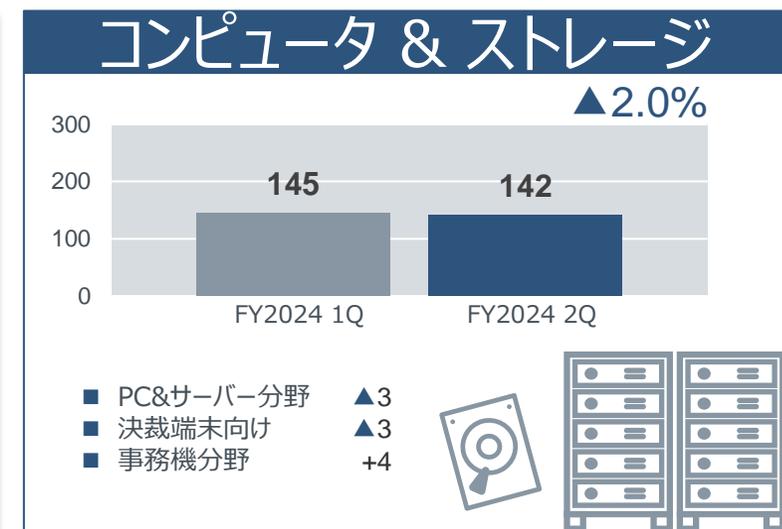
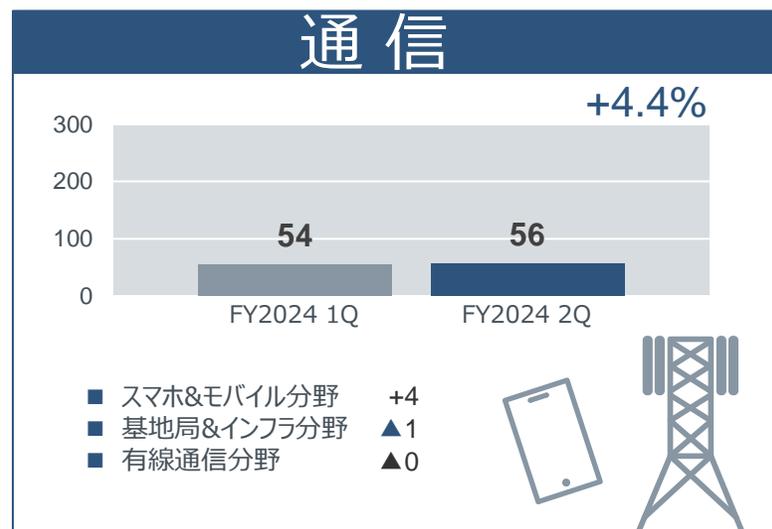
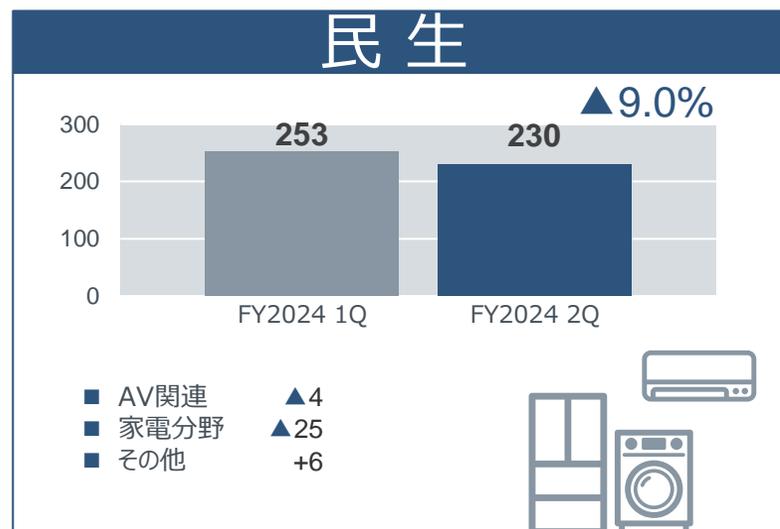
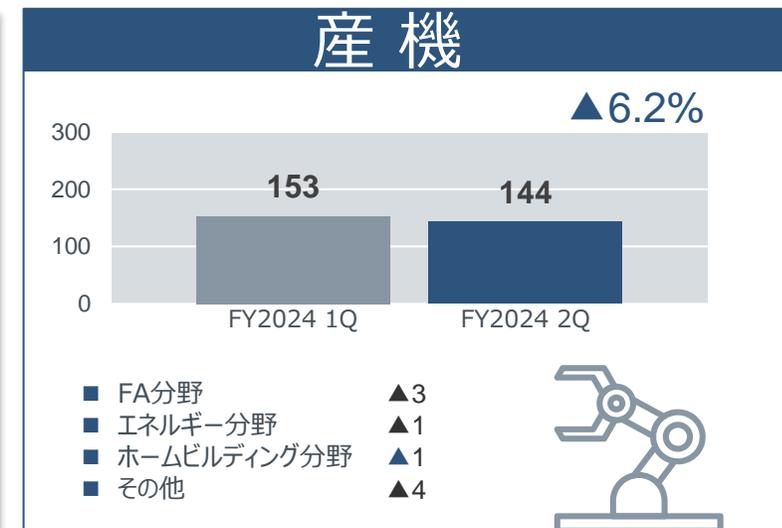
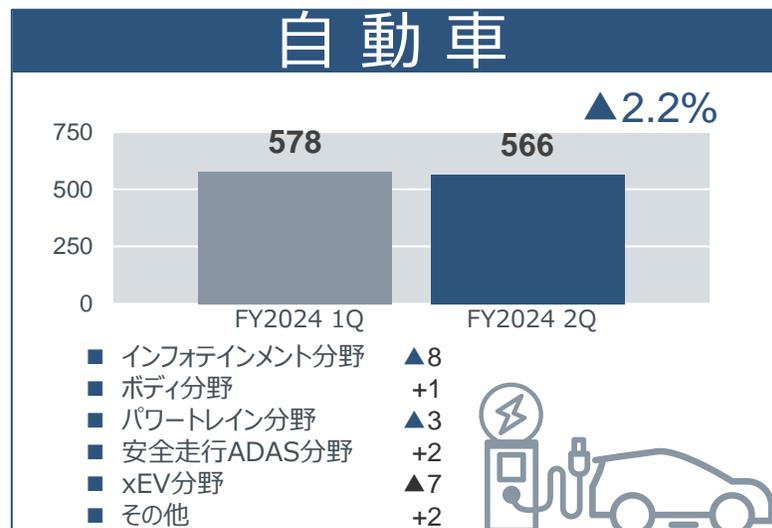
(単位：億円)

	FY2024 第2四半期 実績	FY2023 第1四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,137	1,182	▲45	▲3.8%
営業利益	▲22	12	▲35	-
(対売上比率)	(▲2.0%)	(1.1%)	-	-
経常利益	▲93	92	▲186	-
(対売上比率)	(▲8.2%)	(7.8%)	-	-
純利益	▲13	34	▲48	-
(対売上比率)	(▲1.2%)	(2.9%)	-	-
EBITDA	183	210	▲27	▲13.0%
(対売上比率)	(16.1%)	(17.8%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (150.26円) (156.53円)

期末レート(¥/US\$) (142.73円) (161.07円)

(単位：億円)



2024年度 第2四半期 国籍別 売上の変動要因 (直前四半期比)

四半期売上高

1,182億円

1,137億円

FY2024 第1四半期実績

FY2024 第2四半期実績

▲3.8%

海外売上高比率

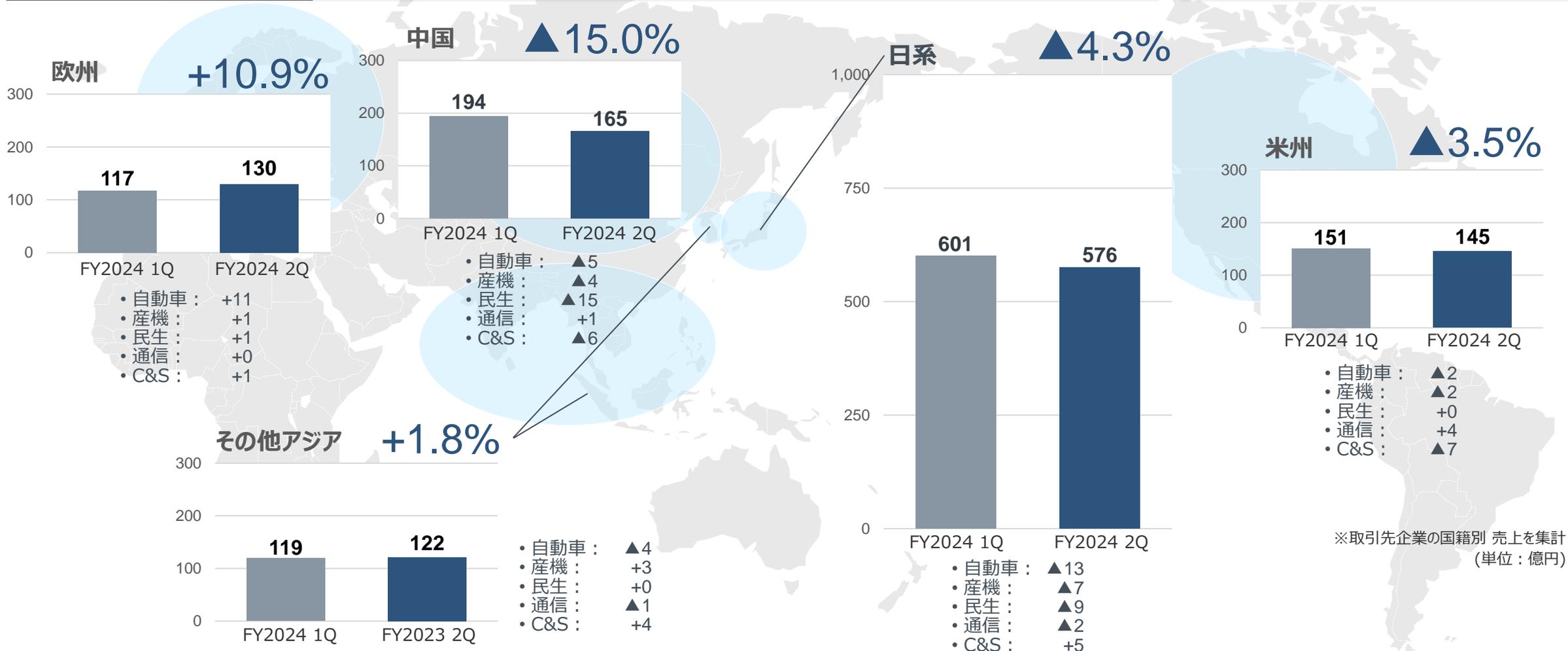
49.1%

FY2024 第1四半期

49.4%

FY2024 第2四半期

第2四半期 直前四半期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

2024年度 第2四半期 営業利益 増減分析 (直前四半期比)



34億円減益

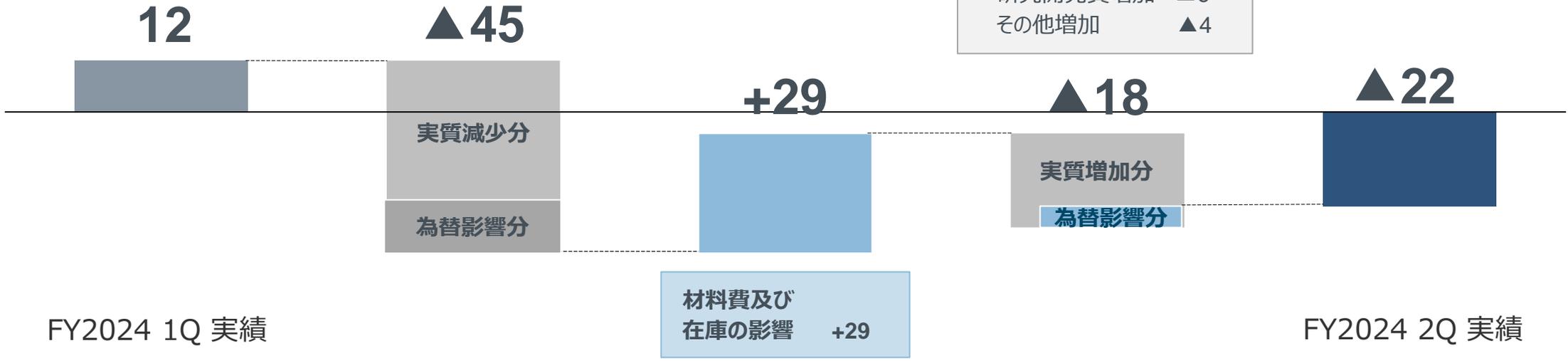
(単位：億円)

売上減少	▲45
(為替影響)	▲33
[実質減少]	▲12

〔内訳〕	
自動車	▲13
産機	▲9
民生	▲23
通信	+2
C & S	▲3

固定費の増加	▲18
(為替影響)	+4
[実質増加]	▲22

〔内訳〕	
・製造原価	
労務費減少	+3
償却費増加	▲7
経費増加	▲4
・販管費	
研究開発費増加	▲6
その他増加	▲4



期中平均レート (¥/US\$) **(156.53円)**

(150.26円)

2024年度 第2四半期 セグメント別 (直前四半期比)

(単位：億円)

		FY2024 第2四半期 実績	FY2024 第1四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	504	537	▲32	▲6.1%
	セグメント利益	15	40	▲24	▲61.8%
	(利益率)	(3.0%)	(7.4%)	-	-
半導体素子	売上	483	489	▲6	▲1.3%
	セグメント利益	▲54	▲49	▲5	-
	(利益率)	(▲11.3%)	(▲10.1%)	-	-
モジュール	売上	87	89	▲1	▲1.5%
	セグメント利益	13	7	+5	+73.4%
	(利益率)	(15.5%)	(8.8%)	-	-
その他	売上	61	66	▲4	▲7.2%
	セグメント利益	8	7	+1	+17.9%
	(利益率)	(13.4%)	(10.6%)	-	-

- [2024-08-21 産機電源に最適なSOPパッケージ汎用AC-DCコントローラIC4種を発売](#)
- [2024-09-05 UAES社とローム、SiCパワーデバイスの長期供給契約を締結](#)
- [2024-09-25 1kW級の高出力赤外レーザーダイオード「RLD8BQAB3」を開発！](#)
- [2024-09-27 芯動半導体とローム、戦略的パートナーシップ契約を締結](#)
- [2024-09-30 デンソーとローム、半導体分野において戦略的パートナーシップの検討開始に合意](#)
- [2024-09-30 体積を従来方式の1000分の1以下に小型化！業界最小※のテラヘルツ波 発振デバイス・検出デバイスのサンプル提供を開始](#)
- [2024-10-01 ESG説明会を開催](#)
- [2024-10-01 社内炭素価格（インターナルカーボンプライシング）制度を導入](#)
- [2024-10-23 ロームのEcoSiC™がコーセル株式会社の3.5kW出力AC-DC電源ユニット「HFA／HCAシリーズ」に採用](#)
- [2024-10-31 ローム独自のHDモノラルモードを搭載！ハイレゾ音源再生に適したMUS-IC™シリーズのオーディオDACチップ第2世代品を開発](#)
- [2024-11-07 車載電動コンプレッサや産業機器インバータ等の高効率化に貢献業界トップクラス※の低損失特性・高短絡耐量を実現した1200V IGBTを開発](#)



Electronics for the Future